



電子部品・実装技術委員会 PRD研究会

2022年度公開研究会 主催:プリントデバイス研究会

◆公開研究会のご案内

◆テーマ プリントブル・ウェアブル材料からセンサーデバイスまで
プリントエレクトロニクス技術は、ソリッド・フレキシブル基板に対して導電性/半導体/絶縁性インクなどの各種印刷技術を駆使して電子デバイスを製造する技術で、更なる軽量化、大面積化、フレキシブル化の要求に応える技術です。また、低コスト化、省エネ化、生産性向上、廃棄物削減などのSDGsの目標に向けても期待される技術です。今回は最新の動向について産学の第一人者の方に講演していただきます。

開催日時 2022年11月21日 13:00～16:40

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:00～13:05

オープニング 電子部品・実装技術委員会 委員長 土門 孝彰 挨拶

13:05～13:55

「テーマ 『5G/6Gに対応する高周波対応基板材料開発動向』のご紹介」
フレックスリンク・テクノロジー株式会社 代表取締役社長 松本博文氏

<概要>

2019年から始動した5G、今後10年以内に5G/6Gと次世代通信システムの進化が更に進む。この次世代無線時代において基板材料、基板プロセスの革新的開発が重要となる。本講演では、それらに対応する高速FCCL(FPC用)、高速RCC(半導体PKG用)、高速RCCL(PCB用)の開発手法や、BS(ボンディングシート)やSR(ソルダーレジスト)の高速対応開発状況も紹介する。

13:55～14:45

「テーマ 『ハイエンド複合構造基板を実現する導電性ペースト技術』のご紹介」
FICT株式会社 経営戦略室 杉本 薫氏

<概要>

データセンター向けを中心とする半導体チップ性能の向上とパッケージング技術の高度化が急加速する中で、特にチップテストに直接かかわる半導体検査装置に用いられる基板が最もハイエンドな基板技術を牽引する状況となってきた。その高性能な要求仕様を実現するために、異形サイズ/異種材料の複合構造や超高多層構造を実現できる導電性ペーストを用いた接合技術を紹介する。

(休憩 15分)

15:00～15:50

「テーマ 『エアロゾルジェット&インクジェット技術によるナノメタルインクを用いた非接触微細配線』のご紹介」
株式会社マイクロジェット 営業部 技術営業グループ 轟 純一氏

<概要>

今回紹介するエアロゾルジェット技術は、曲面や段差部、微小部位に配線やセンサー形成が可能であり、同じ非接触手法であるインクジェット技術と比較しながら応用例を紹介する。

15:50~16:40

「テーマ 『ストレッチャブル印刷配線板の開発と生体デバイス実装への応用』 のご紹介」
大阪大学 産業科学研究所 准教授 荒木徹平氏

<概要>

本講演では、ゴムのような伸縮性や目に見えない透明性など、柔軟・薄膜・透明といった多機能な印刷配線板および、そこへ回路実装したシート型生体デバイスに関わる開発動向を紹介する。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定員 150名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:1,000円

名誉会員: 無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:10,000円 非会員学生:2,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
 - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
 - ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
 - ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
 - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。
- *キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員/賛助/非会員の方

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info¥jiep.or.jp
(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)